



■FO

コンピューターを中心としたFA機器、OA機器やビデオ装置、オーディオ製品、自動車用電子機器、通信用電子機器など電子産業関連機器類の心臓部に使用されている半導体素子。この半導体素子を製造するには、シリコンに代表される半導体結晶ウェファーや化合物半導体結晶ウェファーを、均一に表面加工しなくてはなりません。この表面加工に最適な研磨材が、フジミの技術を結集した精密ラッピング材・FOです。

FOは厳選された材料を使用し、独自の製造工程によって粒形や硬度に特長を持たせたアルミナベースの精密ラッピング材です。厳重な晶質管理のもとで製造されており、つねに安定した研磨能力をもたらすとともに、スクラッチの発生も防止します。したがって半導体結晶だけでなく、レンズやプリズム、硝子等の光学材料にも極めて優れた加工性能を発揮するほか、付加価値の高い加工物に対しても安心してご使用いただけます。

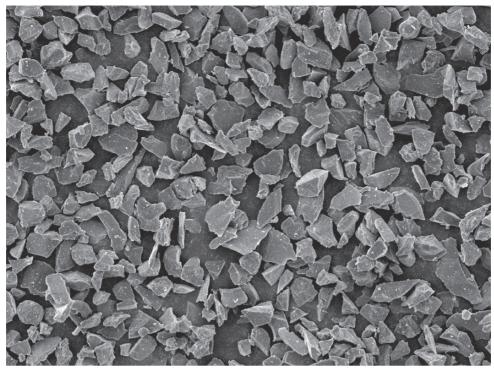
■FO

Found inside nearly every type of electronic devices, ranging from the computers which form the core of Factory and Office Automation equipment, to video devices and audio products, electronic equipment for automobile or communication, semiconductors are the heart and soul of the electronics industry. In producing these semiconductor devices, the surface of the semiconductor wafer, most typically silicon, or a compound semiconductor, must be precisely lapped. The most suitable material to process the surface of semiconductor elements is the product harvested from Fujimi's technology; the precision lapping powder FO. FO is an alumina based precision lapping powder, made by using carefully selected materials, and undergoing Fujimi's own unique processing to produce a powder with special particle shape and hardness. Under the strictest quality control, FO is produced to provide constant, stable lapping capability, with no scratch on the surface of the material being lapped. This being the case, not only is FO effective with semiconductor wafers, it also possesses superior capabilities in the processing of lenses, prisms, and other glassware used for optical applications. Thus, FO can be used with complete confidence, for high value-added workpieces.



本社:〒452-8502 愛知県清須市西枇杷島町地領2-1-1 TEL(052)855-2773

1-1, Chiryo-2, Nishibiwajima-cho, Kiyosu, Aichi, 452-8502 Japan



FO#1200

標準粒度規格 Standard Specifications for Particle Size

粒度 Particle Size		粒度分布 Particle	包装 Packaging			
	最大粒子径 Maximum particle size	累積高さ3% 点の粒子径 Particle size at 3% point	累積高さ50% 点の粒子径 Particle size at 50% point	累積高さ94% 点の粒子径 Particle size at 94% point	スタンドパック 正味重量(kg) Stand pack Net weight (kg)	紙袋入 正味重量(kg) Vinyl lined Net weight (kg)
# 240	≦93.1	≦71.8	38.3~44.7	≧28.7	5	20
# 280	≦81.4	≦64.1	32.5~37.8	≧22.8	5	20
# 320	≦70.6	≦56.3	26.4~31.3	≧18.1	5	20
# 400	≦64.3	≦50.2	22.4~26.9	≧15.5	5	20
# 500	≦54.3	≦43.3	18.7~22.1	≧13.2	5	10 · 20
# 600	≦46.3	≦37.4	15.7~18.5	≧11.0	5	10 · 20
# 700	≦39.3	≦31.5	13.3~15.6	≧8.70	4	20
# 800	≦33.3	≦27.5	11.0~13.0	≧7.00	4	10 · 20
# 1000	≦21.0	≦14.7	10.0~10.6	≧7.00	4	10 · 20
# 1200	≦18.0	≦11.8	7.00~7.50	≧4.20	4	10 · 20
# 1500	≦ 14.0	≦ 10.0	5.30~6.30	≧3.50	4	10 · 20
# 2000	≦13.0	≦9.00	4.20~5.20	≧2.60	4	10 · 20
# 3000	≦ 10.0	≦6.30	3.30~4.10	≧1.70	3	20
# 4000	≦8.50	≦5.40	2.40~3.20	≧1.50	3	20
# 6000	≦8.00	≦5.00	1.60~2.40	≧0.80	3	

粒度測定方法は、電気抵抗法による。 Particle size is measured by Electrical sensing zone methods.

品質規格 Quality Standard

種類	粒 度 Particle size	比 重 Specific Gravity	化学成分 Chemical composition (%)				
Type of product			Al ₂ O ₃	SiO ₂	Fe ₂ O ₃	TiO ₂	ZrO ₂
FO	# 240~# 400	≧3.90	≥45.00	≦20.00	≦0.50	≦2.00	≦38.00
	# 500~# 1200	≧3.90	≧45.00	≦20.00	≦0.50	≦2.00	≦33.00
	# 1500~# 6000	≧3.90	≧40.50	≦25.00	≦0.70	≦2.00	≦33.00